LAGENAUFBAU HDI (Standard)

HDI08_3+2b+3_1,50

8 - Lagen

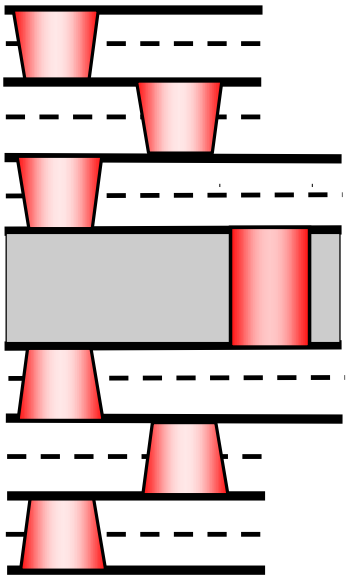
Kern: 0,93 mm Cu 35/35 µm

WE-Artikel Nr.: | **3 + 2B + 3**

KUNDE:

nur CBT Schopfheim

WÜRTH ELEKTRONIK

LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG
KUNDE	WE					[µm]	[µm]
1	TOP/VS		Folie	12 µm	1)	12	
					1 x 1080	60	
2	VSK2		Folie	12 µm		30	
					1 x 1080	60	
3	VSK1		Folie	12 µm		30	
					1 x 1080	58	
4	2			12 µm		35	
			0,930 mm			930	
5	3			12 µm		35	
					1 x 1080	58	
6	RSK1			12 µm		30	
					1 x 1080	60	
7	RSK2		Folie	12 µm		30	
					1 x 1080	60	
8	BOT/RS		Folie	12 µm	1)	12	
			1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm				
					Gesamtdicke Material:	1500	
			Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)				

							Datum:	Bearbeiter:
MATERIALDICKE:	**1,50**	+/-	0,12	mm				
DICKE über galv. Endoberfläche	1,59	+/-	0,15	mm				
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,65	+/-	0,17	mm				
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:			

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision	Seite:
25.04.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	25.04.2006	R. Schönholz	00	23+